

2025年6月4日

各位



【出展のお知らせ】

SmartSensing 2025・SEMISOL 2025 半導体後工程技術&ソリューション展

当社は「SmartSensing 2025・SEMISOL 2025 半導体後工程技術&ソリューション展」に出展いたします。昨年につき、更に充実した内容にて最新の製品や技術をご紹介しますので、この機会に是非、当社ブースにお立ち寄りください。



会 期 : 2025年6月18日(水)～6月20日(金)
開場時間 : 10:00～17:00
会 場 : 東京ビッグサイト 東8ホール
当社ブース : 次世代センサパビリオン内
問い合わせ先 : (株)南陽 産機事業本部 ASS部 [TEL:092-473-7711](tel:092-473-7711)

【展示内容】

1. **新光学ソリューション「X線CT検査装置+ホログラム」**
半導体業界で多数の導入実績を誇る**解像度の高い3次元X線CT検査装置**です。
CT画像を用いた空間再現ディスプレイにて、**立体的に検査対象物の内部構造が把握可能**です。
会場にてCT画像を用いたホログラム解析のデモ実演を予定しております。
2. **新光学ソリューション「Laser Bond Tester」**
レーザー光の熱伝導にて金属接合の内部検査を行う装置です。
ワイヤーボンド工程での剥離強度検査やデバイス開発時の熱抵抗検査が**非破壊・非接触**で瞬時に測定可能です。

3. 新画像検査ソリューション「Multi-Zクロスワイヤ検査機」

3次元パッケージでのクロスワイヤ構造解析、検査を行う装置です。

クロスしているワイヤの隠れている部位やスタックチップの反り、チップ表面検査が一度に測定可能です。

4. クリーンベンチソリューション「オープンクリーンベンチ KOACH」

ISO クラス 1 のクリーン空間を圧倒的な低消費電力かつ囲わないオープンな状態にて空間形成するソリューションを短工期かつ容易に移設、増設が可能です。また、「従来のクリーンルームの常識を覆しただけでなく、我が国の産業、科学技術分野に大きな変革と新たな可能性をもたらす製品」として内閣総理大臣賞を受賞しております。

会場にてデモ実演を予定しております。

【来場登録 URL】

<https://smartsensingexpo.eventos.tokyo/web/portal/1047/event/13176/users/register>

【フロアマップ】



以上